#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002120293 A

(43) Date of publication of application: 23.04.02

(51) Int. CI

B29C 65/16

(21) Application number: 2000314084

(22) Date of filing: 13.10.00

(71) Applicant:

**TOYOTA MOTOR CORP** 

(72) Inventor:

NAKAMURA HIDEO

## (54) METHOD FOR PRODUCING RESIN MOLDING

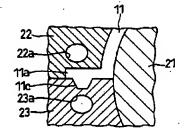
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To heat/melt the contact surfaces of a transmissible resin material and non-transmissible resin material sufficiently by increasing laser beam transmittance in the contact end part of the transmissible resin material and to obtain enough joining strength by welding the contact surface surely to each other.

SOLUTION: A molding mold is used in a molding process, and the first molding member 11 of the transmissible resin material which transmits laser beams as a heating source the second molding member of the non-transmissible resin material which does not transmit the laser beams are molded respectively. The first molding member 11 obtained in the molding process is contacted with the second molding member, and the contact end parts of the both members are welded/joined to each other by being irradiated with the laser beams from the transmissible resin material side (a joining In the molding process, temperature-controlling a part for molding the contact end part 11a locally among the molding molds 21-23 for molding the first molding member 11, the resin

crystallinity of the contact end part 11a is lowered as compared with other parts to increase the laser beam transmittance.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO



### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-120293 (P2002-120293A)

(43)公開日 平成14年4月23日(2002.4.23)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>
B 2 9 C 65/16

識別記号

F I B 2 9 C 65/16 デーマコート\*(参考) 4 F 2 1 1

## 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願2000-314084(P2000-314084)

(22)出顧日

平成12年10月13日(2000.10.13)

(71)出願人 000003207

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

(72)発明者 中村 秀生

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車株式会社内

(74)代理人 100081776

弁理士 大川 宏

Fターム(参考) 4F211 TA16 TC01 TD07 TN27 TQ09

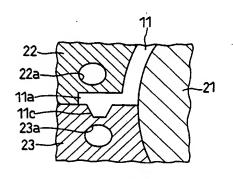
## (54) 【発明の名称】 樹脂成形品の製造方法

## (57)【要約】

【課題】透過性樹脂材の当接端部におけるレーザ光透過率を増大させることにより、透過性樹脂材及び非透過性樹脂材の当接面同士を十分に加熱溶融させ、該当接面同士を確実に溶着させて十分な接合強度を得る。

【解決手段】成形工程で、成形型を用い、加熱源としてのレーザ光に対して透過性のある透過性樹脂材よりなる第1成形部材11と、該レーザ光に対して透過性のない非透過性樹脂材よりなる第2成形部材とをそれぞれ成形する。この成形工程で得られた第1成形部材11及び第2成形部材を当接させ、両者の当接端部同士を透過性樹脂材側からのレーザ光の照射により溶着して接合する

(接合工程)。上記成形工程で、第1成形部材11を成形する成形型21~23のうち当接端部11aを成形する部分を局所的に温度制御することにより、当接端部11aの樹脂結晶化度を他の部分より低くしてレーザ光透過率を増大させる。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 成形型を用い、加熱源としてのレーザ光に対して透過性のある透過性樹脂材と、該レーザ光に対して透過性のない非透過性樹脂材とをそれぞれ成形する成形工程と、

上記成形工程で得られた上記透過性樹脂材及び上記非透過性樹脂材を当接させ、該透過性樹脂材及び該非透過性 樹脂材の当接端部同士を該透過性樹脂材側からの上記レ ーザ光の照射により溶着して接合する接合工程とからな り、

上記成形工程で、上記透過性樹脂材を成形する上記成形型のうち上記当接端部を成形する部分を局所的に温度制御することにより、該透過性樹脂材において該当接端部の樹脂結晶化度を他の部分より低くすることを特徴とする樹脂成形品の製造方法。

【請求項2】 前記成形工程で、前記透過性樹脂材の前記当接端部における樹脂結晶化度が40%以下となるように温度制御することを特徴とする請求項1記載の樹脂成形品の製造方法。

【請求項3】 前記成形工程で、前記透過性樹脂材の前 20 記当接端部における樹脂結晶粒径が5μm以上となるような樹脂材料を該透過性樹脂材に用いることを特徴とする請求項1又は2記載の樹脂成形品の製造方法。

【請求項4】 成形型を用い、加熱源としてのレーザ光に対して透過性のある透過性樹脂材と、該レーザ光に対して透過性のない非透過性樹脂材とをそれぞれ成形する成形工程と、

上記成形工程で得られた上記透過性樹脂材及び上記非透 過性樹脂材を当接させ、該透過性樹脂材及び該非透過性 樹脂材の当接端部同士を該透過性樹脂材側からの上記レ ーザ光の照射により溶着して接合する接合工程とからな り、

上記成形工程で、上記透過性樹脂材を成形する上記成形型のうち少なくとも上記当接端部を成形する部分を温度制御することにより、該透過性樹脂材のうち少なくとも該当接端部の樹脂結晶化度を40%以下とすることを特徴とする樹脂成形品の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は樹脂成形品の製造方 40 法に関し、詳しくは、レーザ光に対して透過性のある透過性樹脂材と、該レーザ光に対して透過性のない非透過性樹脂材とをレーザ溶着により一体的に接合した樹脂成形品の製造方法に関する。

## [0002]

【従来の技術】近年、軽量化及び低コスト化等の観点より、自動車部品等、各種分野の部品を樹脂化して樹脂成形品とすることが頻繁に行われている。また、樹脂成形品の高生産性化等の観点より、樹脂成形品を予め複数に分割して成形し、これらの分割成形品を互いに接合する

手段が採られることが多い。

【0003】ここに、樹脂材同士の接合方法として、従来よりレーザ溶着方法が利用されている。例えば、特開昭60-214931号公報には、レーザ光に対して透過性のある透過性樹脂材と、該レーザ光に対して透過性のない非透過性樹脂材とを重ね合わせた後、該透過性樹脂材側からレーザ光を照射することにより、透過性樹脂材と非透過性樹脂材との当接面同士を加熱溶融させて両者を一体的に接合するレーザ溶着方法が開示されてい

10 る。

【0004】このレーザ溶着方法では、透過性樹脂材内を透過したレーザ光が非透過性樹脂材の当接面に到達して吸収され、この当接面に吸収されたレーザ光がエネルギーとして蓄積される。その結果、非透過性樹脂材の当接面が加熱溶融されるとともに、この非透過性樹脂材の当接面からの熱伝達により透過性樹脂材の当接面が加熱溶融される。この状態で、透過性樹脂材及び非透過性樹脂材の当接面同士を圧着させれば、両者を一体的に接合することができる。

#### 0 [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記したようなレーザ溶着では、透過性樹脂材及び非透過性樹脂材の当接面同士を確実に溶着させて十分な接合強度を得るためには、非透過性樹脂材の当接面(吸収面)にレーザ光のエネルギーを十分に吸収させて、非透過性樹脂材及び透過性樹脂材の当接面を十分に加熱溶融させる必要がある。

【0006】しかしながら、透過性樹脂材やレーザ光の種類等によっては、具体的には透過性樹脂材のレーザ光透過率や加熱源として用いるレーザ光の波長等によっては、非透過性樹脂材の当接面に十分な量のレーザ光を到達、吸収させることが困難になるという問題があった。【0007】本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、透過性樹脂材の当接端部におけるレーザ光透過率を増大させることにより、透過性樹脂材及び非透過性樹脂材の当接面同士を十分に加熱溶融させ、該当接面同士を確実に溶着させて十分な接合強度を得ることのできる樹脂成形品の製造方法を提供することを解決すべき技術課題とするものである。

#### 0 [0008]

【課題を解決するための手段】(1)請求項1記載の樹脂成形品の製造方法は、成形型を用い、加熱源としてのレーザ光に対して透過性のある透過性樹脂材と、該レーザ光に対して透過性のない非透過性樹脂材とをそれぞれ成形する成形工程と、上記成形工程で得られた上記透過性樹脂材及び上記非透過性樹脂材を当接させ、該透過性樹脂材及び該非透過性樹脂材の当接端部同士を該透過性樹脂材側からの上記レーザ光の照射により溶着して接合する接合工程とからなり、上記成形工程で、上記透過性50 樹脂材を成形する上記成形型のうち上記当接端部を成形

する部分を局所的に温度制御することにより、該透過性 樹脂材において該当接端部の樹脂結晶化度を他の部分よ り低くすることを特徴とするものである。

【0009】(2)請求項2記載の樹脂成形品の製造方 法は、請求項1記載の樹脂成形品の製造方法において、 前記成形工程で、前記透過性樹脂材の前記当接端部にお ける樹脂結晶化度が40%以下となるように温度制御す ることを特徴とするものである。

【0010】(3)請求項3記載の樹脂成形品の製造方 法は、請求項1又は2記載の樹脂成形品の製造方法にお 10 いて、前記成形工程で、前記透過性樹脂材の前記当接端 部における樹脂結晶粒径が5μm以上となるような樹脂 材料を該透過性樹脂材に用いることを特徴とするもので ある。

【0011】(4)請求項4記載の樹脂成形品の製造方 法は、成形型を用い、加熱源としてのレーザ光に対して 透過性のある透過性樹脂材と、該レーザ光に対して透過 性のない非透過性樹脂材とをそれぞれ成形する成形工程 と、上記成形工程で得られた上記透過性樹脂材及び上記 非透過性樹脂材を当接させ、該透過性樹脂材及び該非透 20 過性樹脂材の当接端部同士を該透過性樹脂材側からの上 記レーザ光の照射により溶着して接合する接合工程とか らなり、上記成形工程で、上記透過性樹脂材を成形する 上記成形型のうち少なくとも上記当接端部を成形する部 分を温度制御することにより、該透過性樹脂材のうち少 なくとも該当接端部の樹脂結晶化度を40%以下とする ことを特徴とするものである。

#### [0012]

【発明の実施の形態】本発明の樹脂成形品の製造方法 は、成形型を用い、加熱源としてのレーザ光に対して透 30 過性のある透過性樹脂材と、該レーザ光に対して透過性 のない非透過性樹脂材とをそれぞれ成形する成形工程 と、この成形工程で得られた該透過性樹脂材及び該非透 過性樹脂材をレーザ溶着により接合する接合工程とから なる。

【0013】このレーザ溶着は、透過性樹脂材及び非透 過性樹脂材の当接端部同士を当接させた状態で、透過性 樹脂材側からレーザ光を照射することにより行われる。 透過性樹脂材側から照射されたレーザ光は該透過性樹脂 材内を透過して非透過性樹脂材の当接面に到達し、吸収 40 される。この非透過性樹脂材の当接面に吸収されたレー ザ光がエネルギーとして蓄積される結果、非透過性樹脂 材の当接面が加熱溶融されるとともに、この非透過性樹 脂材の当接面からの熱伝達により透過性樹脂材の当接面 が加熱溶融される。この状態で、透過性樹脂材及び非透 過性樹脂材の当接面同士を圧着させれば、両者を一体的 に接合することができる。

【0014】こうして得られた接合部では、当接面同士 が溶融されて接合されており、該当接面同士の間では両

まった状態が形成されているため、強固な接合状態を構 成して高い接合強度及び耐圧強度を有している。

【0015】ここに、本発明の樹脂成形品の製造方法 は、上記成形工程で、上記透過性樹脂材を成形する上記 成形型のうち上記当接端部を成形する部分を局所的に温 度制御することにより、該透過性樹脂材において該当接 端部の樹脂結晶化度を他の部分より低くすることを特徴 とする。

【0016】このように透過性樹脂材において当接端部 の樹脂結晶化度を他の部分より低くすることにより、該 当接端部を透過するレーザ光の透過率を高くすることが できる。このため、非透過性樹脂材の当接面により多く のレーザ光が到達、吸収される。その結果、透過性樹脂 材及び非透過性樹脂材の当接面同士を十分に加熱溶融さ せることができ、該当接面同士を確実にレーザ溶着させ て十分な接合強度を得ることが可能となる。

【0017】したがって、本発明の樹脂成形品の製造方 法によれば、透過性樹脂材の樹脂材料として、レーザ光 透過率が低すぎて従来採用することができなかったよう なものでも採用することが可能となる。

【0018】そして、レーザ溶着する際の透過性樹脂材 におけるレーザ光透過率が26%以上であれば、レーザ 溶着による溶着強度を格段と向上させることができる。 このため、透過性樹脂材に用いる樹脂のレーザ光に対す る透過性や加熱源として用いるレーザ光の波長等に応じ て、透過性樹脂材におけるレーザ光透過率が26%以上 となるように、該透過性樹脂材の当接端部における樹脂 結晶化度を低くすることが好ましい。なお、レーザ光透 過率とは、透過性樹脂材を透過したレーザ光のエネルギ 一の入射光のエネルギーに対する百分率をいう。

【0019】透過性樹脂材を成形する成形型のうち当接 端部を成形する部分を局所的に温度制御するための手段 としては特に限定されないが、例えば、透過性樹脂材の 当接端部を成形する部分の成形型内に冷却水通路を設け る手段等を採用することができる。こうして冷却水路内 を流通する冷却水により、透過性樹脂材の当接端部にお ける溶融樹脂を急速冷却することにより、該当接端部に おける樹脂結晶化度を低くすることができる。

【0020】ここで、レーザ光透過率と樹脂結晶化度と の間には、樹脂結晶化度が低いほどレーザ光透過率が高 くなる関係にあることが、本発明者の実験により確認さ れている。このため、26%以上のレーザ光透過率を確 保すべく、透過性樹脂材の当接端部における樹脂結晶化 度は40%以下であることが好ましく、30%以下であ ることが特に好ましい。なお、樹脂結晶化度の下限値は 0%である。

【0021】また、レーザ光透過率と樹脂結晶粒径との 間には、樹脂結晶粒径が大きいほどレーザ光透過率が高 くなる関係にあることが、本発明者の実験により確認さ 成形部材を構成する両樹脂が溶融して互いに入り込み絡 50 れている。このため、26%以上のレーザ光透過率を確 保すべく、透過性樹脂材の当接端部における樹脂結晶粒 径は5μm以上であることが好ましく、10μm以上で あることが特に好ましい。

【0022】そして、樹脂結晶粒径は、溶融樹脂を冷 却、固化する際の冷却条件(温度制御)によってもある 程度調整することが可能であるが、透過性樹脂材に用い る樹脂材料の種類によってほとんど決まってしまう。し たがって、透過性樹脂材の当接端部における樹脂結晶粒 径が5μm以上となるような樹脂材料を透過性樹脂材に 用いることが好ましい。具体的には、後述する透過性樹 10 脂材に用いることのできる樹脂のうち、ポリプロピレン (PP)、ポリアミド (PA) やポリエチレン (PE) 等を用いることが好ましい。

【0023】また、本発明の樹脂成形品の製造方法は、 上述のとおり、透過性樹脂材において当接端部の樹脂結 晶化度を他の部分よりも低くしておき、接合工程におけ るレーザ溶着時に該当接端部内を透過するレーザ光の透 過率を高くするものである。このため、透過性樹脂材の 当接端部が、樹脂結晶化度の低さに起因して他の部分よ りも強度低下することが懸念される。

【0024】この点、本発明の樹脂成形品の製造方法で は、接合工程におけるレーザ溶着時に透過性樹脂材の当 接端部をレーザ光が透過する際、輻射熱により結晶部分 が内部発熱し、この熱により未結晶部分の結晶化が進 む。このため、本発明の製造方法で得られた樹脂成形品 は、透過性樹脂材の当接端部においても他の部分と同程 度又はそれ以上の強度が確保される。

【0025】したがって、上記接合工程においては、レ ーザ溶着時の輻射熱により透過性樹脂材の当接端部を十 分に結晶化させて、該当接端部において他の部分と同程 30 度の強度を確実に確保することができるように、レーザ 照射条件を設定することが好ましい。具体的には、レー ザ光透過率26%で、200W/secとすることが好 ましい。

【0026】また、上記成形工程で、上記透過性樹脂材 を成形する上記成形型のうち少なくとも上記当接端部を 成形する部分を温度制御することにより、該透過性樹脂 材のうち少なくとも該当接端部の樹脂結晶化度を40% 以下としてもよい。すなわち、透過性樹脂材のうち当接 端部以外の部分が特に高強度を必要としないような場合 40 は、透過性樹脂材を成形する成形型のうち当接端部を成 形する部分のみを局所的に温度制御するのではなく、当 接端部以外の部分を成形する成形型の部分を含めて(場 合によっては透過性樹脂材を成形する成形型全体を) 温 度制御することにより、透過性樹脂材のうち当接端部及 び該当接端部以外の部分の樹脂結晶化度を40%以下と してもよい。そして、この場合、必要に応じて、接合工 程後に該当接端部以外の部分を熱処理等して結晶化を促 進させることにより、高強度化を図ることもできる。

ては、熱可塑性を有し、加熱源としてのレーザ光を所定 の透過率以上で透過させうるものであれば特に限定され ない。例えば、ナイロン6 (PA6) やナイロン66 (PA66) 等のポリアミド(PA)、ポリエチレン (PE)、ポリプロピレン (PP)、スチレンーアクリ ロニトリル共重合体、ポリエチレンテレフタレート (P ET)、ポリスチレン、ABS、アクリル (PMMA) やポリカーボネート(PC)等の他に、レーザ光透過率 が低すぎて透過性樹脂材の樹脂材料として従来採用する ことができなかったPPS(ポリフェニレンサルファイ ド)、ポリプチレンテレフタレート (PBT) やポリス チレン(PS)等を採用することも可能である。なお、 必要に応じて、ガラス繊維、カーボン繊維等の補強繊維 や着色材を添加したものを用いてもよい。

【0028】上記非透過性樹脂材に用いる樹脂の種類と しては、熱可塑性を有し、加熱源としてのレーザ光を透 過させずに吸収しうるものであれば特に限定されない。 例えば、ナイロン6 (PA6) やナイロン66 (PA6 6) 等のポリアミド (PA) 、ポリエチレン (PE) 、 20 ポリプロピレン (PP) 、スチレン-アクリロニトリル 共重合体、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポ リスチレン、ABS、アクリル (PMMA)、ポリカー ボネート (PC)、ポリブチレンテレフタレート (PB T)、PPS等に、カーボンブラック、染料や顔料等の 所定の着色材を混入したものを挙げることができる。な お、必要に応じて、ガラス繊維やカーボン繊維等の補強 繊維を添加したものを用いてもよい。

【0029】また、上記透過性樹脂材に用いる樹脂と上 記非透過性樹脂材に用いる樹脂との組合せについては、 互いに相溶性のあるもの同士の組合せとされる。かかる 組合せとしては、ナイロン6同士やナイロン66同士 等、同種の樹脂同士の組合せの他、ナイロン6とナイロ ン66との組合せ、PETとPCとの組合せやPCとP BTとの組合せ等を挙げることができる。

【0030】また、加熱源として用いるレーザ光の種類 としては、レーザ光を透過させる透過性樹脂材の吸収ス ペクトルや板厚(透過長)等との関係で、透過性樹脂材 内での透過率が所定値以上となるような波長を有するも のが適宜選定される。例えば、YAG:Nd3+レーザ (レーザ光の波長:1060nm) や半導体レーザ (レ ーザ光の波長:500~1000nm)を用いることが

【0031】なお、レーザの出力、照射密度や加工速度 (移動速度) 等の照射条件は、樹脂の種類等に応じて適 宜設定可能である。

[0032]

【実施例】以下、本発明の具体的な実施例を図面に基づ いて説明する。

【0033】本実施例は、本発明に係る樹脂成形品を合 【0027】上記透過性樹脂材に用いる樹脂の種類とし 50 成樹脂製のインテークマニホールドに適用したものであ

10

る。

【0034】図1はインテークマニホールドの平面図で ある。図2はインテークマニホールドの図1におけるA - A線で切断した切断端面を拡大して示している。

【0035】このインテークマニホールド10は、上下 に2分割されていて、上側分割体である第1成形部材1 1と下側分割体である第2成形部材12とから構成され た中空体である。第1成形部材11及び第2成形部材1 2は、互いに整合して当接し合うフランジ部よりなる当 接端部11a及び12aをそれぞれ有している。そし て、第1成形部材11の当接端部11a及び第2成形部 材12の当接端部12aの当接面11b及び12b同士 がレーザ溶着により一体的に接合されている。

【0036】第1成形部材11は、加熱源としてのレー ザ光に対して透過性のある透過性樹脂よりなるもので、 この透過性樹脂として、本実施例ではPA66に補強材 であるガラスファイバーを30wt%添加してなる強化 プラスチックを用いた。なお、照射に使用するレーザ光 はYAG: Nd³+レーザ (波長:1060nm) であ

【0037】また、第2成形部材12は、加熱源として のレーザ光に対して透過性のない非透過性樹脂よりなる もので、この非透過性樹脂として、本実施例ではPA6 6に補強材であるガラスファイバーを30wt%、補助 剤(着色材)であるカーボンブラックを適宜量添加して なる強化プラスチックを用いた。

【0038】なお、第1成形部材11及び第2成形部材 12は、いずれもPA66を母材樹脂とするもので、互 いに相溶性のあるものである。

【0039】第1成形部材11は、図1のA-A線で示 30 す部位が図2で拡大して示されているように、断面形状 が略半円筒状を呈している。この略半円筒状をなす第1 成形部材11の開口端部に、遠心方向に膨出するフラン ジ部よりなる当接端部11aが設けられている。

【0040】そして、この部分がさらに拡大して図3に 示されているように、当接端部11aには、その下面 (当接面11b) に、下方に突出する環状の嵌合凸部1 1 cが設けられている。この嵌合凸部 1 1 cは、先端側 (下方側) に向かって漸次縮小して突出する略台形状の 断面形状をなしている。

【0041】一方、第2成形部材12の当接端部12a には、その上面(レーザ光の吸収面となる当接面12 b) に、上記嵌合凸部11cと嵌合可能な環状の嵌合凹 部12cが設けられている。この嵌合凹部12cは、上 記嵌合凸部11 cと整合する形状とされ、底面から上方 (レーザ光が照射される側) に向かって漸次開口が拡が る略台形状の断面形状をなしている。

【0042】そして、第1成形部材11の嵌合凸部11 c及び第2成形部材12の嵌合凹部12c同士が嵌合さ れるとともに、第1成形部材11の当接面11b (嵌合 50

凸部11cの傾斜側面及び先端面を含む)及び第2成形 部材12の当接面12b(嵌合凹部12cの傾斜側面及 び底面を含む) 同士がレーザ溶着により一体的に接合さ れている。

【0043】上記構成を有する本実施例に係る樹脂成形 品は、以下のようにして製造した。

【0044】(成形工程)まず、所定の射出成形型を用 いて、第1成形部材11及び第2成形部材12を予め所 定形状に射出成形した。

【0045】このとき、透過性樹脂材よりなる第1成形 部材11は、図4に示すように、第1~第3成形型21 ~23を用いて射出成形した。第1成形部材11の当接 端部11aを成形する第2及び第3成形型22及び23 には、該当接端部11 aを成形する型面の近傍に冷却水 通路22a及び23aが設けられている。そして、各冷 却水通路22a及び23aに冷却水を流通させつつ、射 出成形することにより、第1成形部材11を成形する第 1~第3成形型において当接端部11aを成形する部分 のみを局所的に温度制御した。こうして第1成形部材1 20 1において、当接端部11aにおける溶融樹脂を急冷し て、該当接端部11aにおける樹脂結晶化度を他の部分 よりも低くした。

【0046】具体的には、冷却水により第2及び第3成 形型22及び23のうち当接端部11aを成形する部分 のみを局所的に20~25℃程度の型温に冷却した。こ うして、第1成形部材11において、当接端部11aに おける樹脂結晶化度を20~25%程度とし、またこの 当接端部11aにおける樹脂結晶粒径を5~10μm程 度とした。したがって、この当接端部11aにおけるレ ーザ光透過率は40~50%程度とされている。なお、 第1成形部材11の当接端部11a以外の部分を成形す る第1~第3成形型21~23の他の部分は60~80 ℃程度の型温である。また、第1成形部材11において 当接端部11a以外の部分における樹脂結晶化度は30 ~35%程度である。

【0047】 (接合工程) そして、第1成形部材11の 嵌合凸部11cと第2成形部材12の嵌合凹部12cと を嵌合させるとともに、第1成形部材11及び第2成形 部材12の当接面11b及び12b同士を当接させた。 40 この状態で、図示しないレーザトーチを用い、第1成形 部材11側からレーザ光を照射した。すなわち、第1成 形部材11の当接端部11aの上面側からレーザ光を照 射して該当接端部11aの上面からレーザ光を入射させ ることにより、第1成形部材11の当接端部11aと第 2成形部材12の当接端部12aとの当接面11b及び 12 b 同士を全面的に加熱溶融させて、レーザ溶着によ り両者を一体的に接合した。

【0048】こうして得られた接合部では、当接面11 b及び12b同士が全面的に溶融されて接合されてお り、該当接面11b及び12b同士の間では両成形部材

11及び12を構成する両樹脂が溶融して互いに入り込 み絡まった状態が形成されているため、強固な接合状態 を構成して高い接合強度及び耐圧強度を有している。

【0049】特に、本実施例では、上記成形工程で得ら れた透過性樹脂材よりなる第1成形部材11の当接端部 11aは、樹脂結晶化度が20~25%程度と低く、ま た樹脂結晶粒径が5~10μm程度と大きい。このた め、この当接端部11aにおけるレーザ光透過率は40 ~50%程度と高くなっている。したがって、上記接合 工程におけるレーザ溶着時に、非透過性樹脂材よりなる 10 第2成形部材12の当接面12bにより多くのレーザ光 が到達、吸収される。その結果、第1成形部材11及び 第2成形部材12の当接面11b及び12b同士を十分 に加熱溶融させることができ、該当接面11b及び12 b同士を確実にレーザ溶着させて十分な接合強度を得る ことが可能となる。

【0050】また、上記接合工程におけるレーザ溶着時 に透過性樹脂材よりなる第1成形部材11の当接端部1 1 aをレーザ光が透過する際、輻射熱により結晶部分が 内部発熱し、この熱により未結晶部分の結晶化が進む。 このため、上記成形工程では、第1成形部材11におい て当接端部11aにおける樹脂結晶化度が他の部分より も低いものであったが、接合工程を経て得られた本実施 例に係る樹脂成形品は、該当接端部11 aにおいても他 の部分と同程度又はそれ以上の強度が確保される。

【0051】一方、本実施例に係る樹脂成形品では、第 1成形部材11の嵌合凸部11cと第2成形部材12の 嵌合凹部 1 2 c との凹凸嵌合により、両者間に機械的な 結合力が付与せしめられるので、両者の接合強度をより 向上させることができる。

【0052】また、凹凸嵌合による機械的な結合力によ り、第1成形部材11及び第2成形部材12の当接端部 11a及び12aにおける反り等が矯正されるので、第 1成形部材11及び第2成形部材12の当接面11b及 び12b同士の間に隙間が発生することを抑えることが できる。このため、非透過性樹脂材よりなる第2成形部 材12の当接面12bにおける発熱を透過性樹脂材より なる第1成形部材11の当接面11bに確実に熱伝達さ せて、第1成形部材11の当接面11bを確実に加熱溶 融させることができる。したがって、第1成形部材11 40 の透過性樹脂材料を成形した。 及び第2成形部材12の当接面11b及び12b同士を 確実にレーザ溶着させることが可能となる。

【0053】また、上記凹凸嵌合により、第1成形部材 11の上記当接面11b (嵌合凸部11dの傾斜側面及 び先端面を含む)と第2成形部材12の上記当接面12 b (嵌合凹部12dの傾斜側面及び底面を含む) との当 接面積、すなわちレーザ溶着による接合面積も増大する ことから、これによっても接合強度の向上を図ることが

【0054】さらに、透過性樹脂材よりなる第1成形部 50

材11に上記嵌合凸部11cを設けるとともに、非透過 性樹脂材よりなる第2成形部材12に上記嵌合凹部12 cを設けているので、該嵌合凹部12cの内面(底面及 び傾斜側面) でレーザ光の一部が反射することを利用す ることができ、より均一にレーザ溶着するのに有利とな る。

【0055】(樹脂結晶化度及び樹脂結晶粒径とレーザ 光透過率との関係) 射出成形時の成形型温を変更するこ とにより、種々の樹脂結晶化度を有する板厚3mmの透 過性樹脂材を成形した。

【0056】また、透過性樹脂材として用いる樹脂材料 の種類を種々変更することにより、種々の樹脂結晶粒径 を有する板厚3mmの透過性樹脂材を成形した。

【0057】そして、YAG:Nd3+レーザ (波長:1 060nm)を各透過性樹脂材に板厚方向に照射して、 各該透過性樹脂材におけるレーザ光透過率を測定し、樹 脂結晶化度及び樹脂結晶粒径とレーザ光透過率との関係 を調べた。このときのレーザの出力は400Wとした。 また、レーザ光透過率は、入射エネルギーをワーク有無 20 で算出することにより測定した。

【0058】樹脂結晶化度とレーザ光透過率との関係を 図 5 に示すように、樹脂結晶化度が低いほどレーザ光透 過率が高くなり、樹脂結晶化度が40%以下であれば、 レーザ光透過率が26%以上になることがわかる。

【0059】また、樹脂結晶粒径とレーザ光透過率との 関係を図6に示すように、樹脂結晶粒径が大きいほどレ ーザ光透過率が高くなり、樹脂結晶粒径が5μm以上で あれば、レーザ光透過率が26%以上になることがわか

30 【0060】なお、図6において、樹脂結晶粒径が2μ mとなった透過性樹脂材の樹脂材料はPBTであり、樹 脂結晶粒径が 5 μ m となった透過性樹脂材の樹脂材料は PA66である。

【0061】次に、PA66とPPSの2種類の樹脂材 料を準備した。

【0062】そして、一方の樹脂材料 (PA66) につ いて、射出成形時の成形型温を20℃、80℃と変更す ることにより、それぞれ30%、40%の樹脂結晶化度 を有し、樹脂結晶粒径が5~10μmで板厚1~5mm

【0063】また、他方の樹脂材料 (PPS) につい て、射出成形時の成形型温を20℃、80℃と変更する ことにより、それぞれ30%、60%の樹脂結晶化度を 有し、樹脂結晶粒径が1μm以下で板厚1~5mmの透 過性樹脂材料を成形した。

【0064】そして、上記と同様にYAG:Nd³+レー ザ (波長:1060nm) を各透過性樹脂材に板厚方向 に照射して、各該透過性樹脂材におけるレーザ光透過率 を測定した。

【0065】その結果を図7に示すように、樹脂結晶化

11

度の低下と樹脂結晶粒径のサイズアップがレーザ光透過 の決め手であることがわかる。

【0066】 (レーザ光透過率と溶着強度との関係) ガラス繊維が30wt%添加されて強化されたナイロン6からなる板厚3mmの透過性樹脂材と、カーポンプラックが所定量添加されたナイロン6からなる板厚3mmの非透過樹脂材とを重ね合わせ、YAG:Nd³+レーザ

(波長:1060nm)を透過性樹脂材側から照射して、レーザ溶着により一体的に接合した。なお、レーザの出力は400W、加工速度は4m/minとした。

【0067】そして、透過性樹脂材に着色剤としての染料を添加し、その添加量を種々変更することにより、透過性樹脂材におけるレーザ光透過率を種々変更して、透過性樹脂材におけるレーザ光透過率と溶着強度との関係を調べた。なお、レーザ光透過率は上記と同様に測定し、また溶着強度は溶着部を引張り破断することにより測定した。その結果を図8に示す。

【0068】図8から明らかなように、透過性樹脂材におけるレーザ光透過率が26%以上あれば、溶着強度が45MPa以上となり、十分な溶着強度を達成できるこ 20とがわかる。

### [0069]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の樹脂成形品の製造方法によれば、透過性樹脂材の当接端部における樹脂結晶化度を低くしてレーザ光透過率を増大させることにより、レーザ溶着時に透過性樹脂材及び非透過性樹脂材の当接面同士を十分に加熱溶融させ、該当接面同士を確実にレーザ溶着させて十分な接合強度を得ることができる。

【0070】また、上記当接端部はレーザ溶着時の輻射 30 熱で結晶化が進むから、本発明方法で得られた樹脂成形 品においては、樹脂結晶化度の低さに起因して上記当接

端部で強度低下するようなこともない。

【0071】さらに、透過樹脂材におけるレーザ光透過 率が増大すれば、レーザ光のエネルギーをより効率的に レーザ溶着に利用することが可能となり、消費エネルギ ーの節約によりコスト低減にも寄与しうる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例に係り、本発明に係る樹脂成形品を適用 する合成樹脂製のインテークマニホールドの平面図であ る。

10 【図2】実施例に係り、図1の矢印A-A線で示す部位の断面図である。

【図3】実施例に係り、第1成形部材と第2成形部材と の接合構造を示す拡大部分断面図である。

【図4】実施例に係り、透過性樹脂材よりなる第1成形部材の当接端部を成形する様子を示す部分断面図である。

【図5】樹脂結晶化度とレーザ光透過率との関係を示す 線図である。

【図6】樹脂結晶粒径とレーザ光透過率との関係を示す 20 線図である。

【図7】樹脂結晶化度及び樹脂結晶粒径とレーザ光透過率との関係を示す線図である。

【図8】透過性樹脂材におけるレーザ光透過率と溶着強度との関係を示す線図である。

#### 【符号の説明】

11…第1成形部材(透過性樹脂材)

12…第2成形部材(非透過性樹脂材)

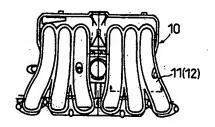
1 1 a、1 2 a…当接端部

11b、12b…当接面

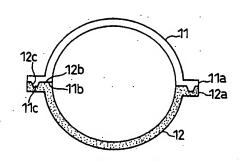
70 11 c … 嵌合凸部

1 2 c …嵌合凹部

【図1】



[図2]



| 1 …第1成形部材(透過性樹脂材) | 2 …第2成形部材(非透過性樹脂材) | 1 a, 12 a …当接癌部

